

GAP-245PL - Serie G6 SERVER RUGGED 2U

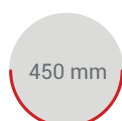


Intel® Xeon® Scalable

I/O Motherboard e Alimentatore Frontali



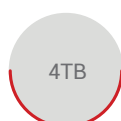
Piattaforma



Profondità



CPU



RAM



SSD



Schede I/O

GAP è una linea di server e workstation rugged realizzati in alluminio, progettati per applicazioni che richiedono un apparato robusto e qualificato, adatto a operare in ambienti critici.

I server rugged GAP-245PL Serie G6 integrano singolo o doppio processore della serie Intel® Xeon® Scalable Processors (Skylake-SP / Cascade Lake-SP) che offre fino a 28 core e 56 thread, fino a 38.5 MB di cache L2, la nuova UPI (Ultra Path Interface), fino a sei canali di memoria, supporto AVX-512 e fino a 48 linee PCIe 3.0. I servizi di IPMI supportati consentono il controllo locale e remoto dei dispositivi integrati e permettono la segnalazione di allarmi e l'intervento immediato in caso di criticità.

GAP-245RL è progettato per montaggio a rack 19", è caratterizzato da 2U di altezza e 450mm di profondità. La configurazione con I/O motherboard e alimentatore frontali offre tutte le porte della motherboard e delle schede integrate sul lato anteriore dello chassis per installazioni "front only". I server rugged serie GAP-245PL possono integrare fino a sei schede PCIe low profile.

I server rugged GAP sono conformi alle MIL-STD-810F per temperatura e shock, alle MIL-STD-167-1A per vibrazioni e opzionalmente alle normative MIL-STD-461. Su richiesta gli I/O e l'ingresso di alimentazione possono essere dotati di connettori MIL-GRADE.

Tutte le configurazioni sono accompagnate da inventory list per garantire il controllo della configurazione e la riproducibilità nel tempo. Su richiesta gli apparati integrati possono essere sottoposti a specifici profili di stress termico o meccanico.

CARATTERISTICHE

- Server Rugged 2U - 450mm profondità
- Singolo o doppio processore
- Intel Xeon® Scalable (I e II Gen)
- I/O motherboard frontali
- Ingresso di alimentazione frontale
- Alimentatore ridondato AC o DC
- Fino a 3 SSD Hot Swap (Max 2 x NVME)
- DVD opzionale
- Fino a 6 schede Low Profile
- Conformal Coating opzionale
- MIL-STD-810G
- MIL-STD-461 opzionale

Specifiche Tecniche

Sistema

Processore	Famiglia Intel® Xeon® Scalable (fino a 250W TDP) - Doppio Socket P (LGA 3647) - Fino a 28 core
Memoria	Fino a 4TB ECC RDIMM, DDR4- 2933/2666/2400/2133MHz – 16 DIMM slot
Chipset	Intel® C621
Porte rete	2 x RJ45 Gigabit Ethernet
Storage	2.5" SATA Disk - RAID 0, 1, 5, 10 PCIe 3.0 NVMe x4 Port Interna M.2: PCI-E 3.0 x4 - 2260, 2280, 22110 M.2 Key: M-Key
TPM	1 TPM Header
I/O motherboard	Disponibili sul fronte: 1 x VGA, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 2 x GbE, 1 x IPMI LAN, 1 x COM
Schede aggiuntive	Fino a 6 Schede PCIe Low profile
Sistemi operativi	Windows® 8.1, Windows® 10 IoT Enterprise 2016, Windows® Server 2012 R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019, Linux, Vmware, Xen Server
IPMI	IPMI2.0, SPM, Watchdog; notifica degli allarmi via SNMP ed e-mail
Monitoraggio remoto	Controllo delle funzionalità di sistema (velocità ventole, temperature, tensioni, alimentazione, consumi, stato dei dischi, stato delle memorie e della configurazione RAID)

Alimentazione

Alimentatore	100/240 VAC Ridonato 18-36 VDC Singolo o Ridonato 36-72 VDC Singolo o Ridonato
---------------------	--

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni	483 x 88 x 450 mm
Materiale	Alluminio con trattamento di passivazione superficiale
Colore	Silver
Alloggiamento	Chassis 2U per montaggio a rack 19" Guide telescopiche opzionali
Configurazione	I/O motherboard e alimentatore frontali
Pannello frontale	Led: Led Power ON e funzionalità HDD/SSD; Pulsanti: Power ON / OFF e System Reset
Baie Drive	1 x 5.25" slim; 1 x baia 3.5"

Parametri Ambientali - (Design to meet)

Temperatura operativa	Standard: 0°C / +50°C Estesa: -20°C / +60°C (in funzione delle configurazioni)
Umidità operativa	Da 8% a 95% non-condensata (in funzione delle configurazioni)
Temperatura storage	-40°C / +70°C
Vibrazioni	MIL-STD-810G, Method 514.7, Cat 4 - Proc. I - 2.24 Grms, 5-500 Hz 60 min/axis for 3 axes
Shock operativo	MIL-STD-810G Proc. I Method 516.7 - 15g / 11ms – half sine
Shock trasporto	MIL-STD-810G Proc. II Method 516.7 - 30g / 9ms sawtooth
Certificazioni	Direttiva 2014/35/UE-LVD / Direttiva 2014/30/UE-EMC Direttiva 2011/65/UE - RoHS / Regolamento (EC) No 1907/2006 - REACH

I server e le workstation GAP sono progettati in conformità alle specifiche ambientali indicate. Alcuni parametri dipendono dalla configurazione. Gli apparati possono essere sottoposti a profili di prova dedicati.